

中信证券股份有限公司
关于深圳天德钰科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“天德钰”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2026 年 4 月 3 日及 2026 年 4 月 20 日对公司进行了现场检查
。督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司出具的 2025 年度内部控制评价报告、会计师出具的 2025 年度公司内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2025 年度审计报告、2025 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

根据上市公司披露的 2025 年报并经访谈上市公司管理人员，本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 核心竞争力风险

为紧抓市场需求、加强终端客户导入力度，公司需要持续升级现有产品并开发新产品。产品的持续开发需投入大量的人力及财力，若公司对市场需求方向或技术方向发生误判，或研发过程中未对关键技术实现突破、研发结果未能达到预期效果，则存在研发失败的风险，进而无法收回前期研发投入，对公司财务状况产生不利影响。

(二) 经营风险

公司的经营风险主要来源于市场价格竞争以及原材料成本波动等因素。

1、显示驱动相关领域行业竞争加剧的风险

随着国内液晶显示行业快速发展，显示驱动 IC 相关市场的竞争日趋激烈，

同行业企业加速技术升级、产品优化。若未来行业竞争加剧，产品价格水平可能下滑，若公司未能及时推出新产品、提高管理水平以应对市场竞争，则存在因市场竞争加剧导致盈利下滑的风险。

2、晶圆供应周期性波动的风险

公司作为集成电路设计企业，采用 Fabless 经营模式，将晶圆制造与封装测试环节由晶圆厂及封测厂完成。在半导体产业供需关系波动的影响下，上游晶圆制造产能相对紧缺。目前，公司通过积极拓展多方晶圆供应渠道等方式，在一定程度上维持了晶圆供应的稳定性。若市场景气度上升，下游市场需求旺盛导致产能紧张晶圆供应可能无法满足需求，将对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。

3、新产品开发及时性的风险

公司业绩增长既受益于行业供需变化的影响，亦受益于新产品不断研发成功并实现量产的影响。随着下游客户需求不断多样化，如 Micro-OLED 等新型显示材料逐渐商业化、客户对手机等电子产品更加追求轻薄化、多功能化等，对芯片功能及性能要求更高，研发设计难度随之提高，若公司未来不能及时研发出新产品或研发的产品不能满足市场需求，则营业收入及盈利水平将无法继续保持较高增长的风险。

（三）财务风险

1、存货跌价风险

报告期内存货周转天数一直比较稳定，维持良好库存水位。期末，公司存货金额较大，受未来市场需求变化、产品迭代、价格变化等不确定因素影响，若公司未来不能合理控制存货规模，优化库存结构，可能会使公司面临或增加存货积压、发生跌价的风险。

2、汇率波动的风险

公司的记账本位币为人民币。报告期内，公司存在境外采购及销售的情况，并主要通过美元等外币进行结算。虽然公司在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，同时考虑了订单处理及款项收付之间汇率可能产生的波动，

但公司难以预判未来经济环境、货币政策、政治形势的变化，难以预判未来人民币与美元等外币之间汇率波动的形势。若未来美元等外币汇率发生大幅波动，可能会使公司面临或增加较大的汇兑损失风险，影响利润水平的波动，对公司未来经营业绩的稳定造成不利影响。

（四）行业风险

公司深耕集成电路设计行业多年，围绕移动智能终端领域进行深入布局，产品线涵盖移动智能终端显示驱动芯片、电子价签驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片及快充协议芯片。行业需求及下游应用领域发展向好。但近年来，随着行业内企业尤其中国大陆企业参与者持续增多，行业竞争日趋激烈。若公司未来未能及时进行产品性能改进或及时推出新产品，将存在因市场竞争日趋激烈导致的市场份额下滑、毛利率下滑的风险。

（五）宏观环境风险

集成电路行业为国民经济重要行业，其发展受宏观经济波动影响。公司主营产品广泛应用于手机、平板、智能音箱、智能穿戴、快充/移动充电、智慧零售等领域，不可避免地受到宏观经济波动、下游需求变化的影响。若未来宏观经济继续波动，下游需求出现剧烈变化，将会间接导致公司产品销量波动或产品结构调整。目前，集成电路行业获得国家政策支持，发展相对较快。但若未来国内集成电路产业政策发生变化，将对集成电路行业带来影响，进而影响公司业务发展。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	218,956.72	210,197.27	4.17
归属于上市公司股东的	25,080.71	29,174.71	-14.03

净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,351.36	27,488.08	-15.05
经营活动产生的现金流量净额	28,085.07	13,692.66	105.11
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	240,682.56	218,014.86	10.40
总资产	279,391.96	257,428.88	8.53
主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.57	0.68	-16.18
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.68	-16.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.61	-14.93
加权平均净资产收益率(%)	10.22	13.43	减少3.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.60	12.09	减少2.49个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	9.40	8.36	增加1.04个百分点

2025 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 28,085.07 万元，较上年增加 14,392.41 万元，同期增长 105.11%，主要系销售商品收到的现金增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

根据上市公司披露的 2025 年报，公司核心竞争力及其变化情况如下：

（一）公司的核心竞争力

1、研发能力优势

公司始终坚持以技术创新与产品升级为核心发展战略，持续稳定加大研发投入，为产品迭代升级与技术创新布局提供坚实保障。公司聚焦主营业务，深耕核心产品领域，不断提升产品品质与综合性能。依托长期技术积累与持续的产品打磨、迭代优化，公司研发体系日趋成熟，研发能力显著增强，产品更新迭代效率持续提升，核心竞争力不断强化，市场份额稳步提高。

2、人才和团队优势

研发与运营团队是公司发展的两大核心支撑。公司研发团队核心成员均拥有多年集成电路行业深耕经验，具备扎实的专业功底与突出的研发设计能力，能够敏锐洞察行业趋势与市场需求，高效完成项目立项、产品开发及成果转化，快速将客户需求落地为规模化量产产品。

公司供应链、生产、销售及市场等运营管理团队核心成员均具备深厚的行业积累与专业背景，在供应链协同、生产组织、市场拓展及客户服务等方面经验丰富，可有效保障公司采购、生产、销售及市场推广等环节稳定高效运行，持续提升产品品质与服务质量，快速响应市场变化，为公司经营决策的及时性与科学性提供有力支撑。

3、高度系统化管理，人效较高

公司坚持精细化、系统化、数字化运营管理，持续优化组织效能与业务流程，整体人员效率保持较高水平。通过数字化工具与高效管理体系赋能研发、运营各环节，有效提升运营效率、严控成本费用，实现了人力资源的合理配置与高效利用，为公司持续健康发展提供坚实保障。

4、覆盖全球优质客户

公司凭借稳定的产品质量与卓越的客户服务，已累积丰富的国内外终端客户资源。产品广泛应用于手机、平板、智慧音箱、穿戴装置、快充设备、智慧零售、智慧办公与智慧医疗等多元领域，具备高度产品多样性，能满足不同应用场景的需求。产品广泛应用于三星、VIVO、OPPO、荣耀等手机品牌，亚马逊、谷歌、百度、小米等平板、智能音箱客户，360、Tik Tok 等智能穿戴客户。

除消费性电子外，公司亦积极拓展工控与零售应用市场。在工控领域，产品已导入三星家电、海信家电、GoPro、新大陆、联迪 POS 机、海康监控器及中控仪表台等设备。

在智慧零售方面，公司 ESL（电子货架标签）芯片已被全球多家零售巨头采用，涵盖国际客户如家乐福、麦德龙、欧洲的 Auchan、Aldi、Ahold、美国 Lowe's、英国 Tesco、西班牙 BonPreu 等；国内则包括华润万家、多点集团、永辉超市、

盒马、山姆会员店等。

在产业链合作方面，公司与模块厂、面板厂、系统厂及终端品牌客户维持密切合作，并与京东方（BOE）、群创光电、华星光电、清越电子、国显科技、星源电子、华勤通讯、闻泰科技、龙旗通讯等知名企业建立稳定伙伴关系。

优质且多元的全球客户资源，有助于公司持续扩大产品业务规模，加速新技术与新产品的市场导入，为未来长远发展奠定坚实基础。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	20,587.65	17,574.58	17.14
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	20,587.65	17,574.58	
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.40	8.36	增加 1.04 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2025 年度，公司研发投入增加，主要系公司加大对新产品的研发投入力度。

（二）研发进展

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司研发费用明细、大额研发支出凭证、研发项目进展相关资料，查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，了解公司研发支出及研发进展情况。公司研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	USB-PD	1,000.00	550.56	550.56	在研	固件化集成外围组件	国	旅充、墙

	控制芯片					快充协议控制芯片，支持 OPTO 输出功率 Max 65W，以提高简化设计。	国内先进	充、排插等充电装置
2	USB-PD 控制芯片	1,500.00	397.26	875.05	在研	首创固件化快充协议控制芯片，多组 FBO/OPTO 可同时提供客制化多种输出功率，以提高使用便利性。	国内先进	车充、旅充、墙充、排插等充电装置
3	用于 USB Cable 的 E-Marker 芯片	1,600.00	453.57	1,091.55	在研	具有电子标签 ID 识别功能，让充电线识别 240W 充电功率。	国内先进	用于各式移动装置充电线
4	USB-PD 控制芯片	800.00	645.48	645.48	在研	首创固件化多口应用快充协议控制芯片，多组 FBO/OPTO 可同时提供四种电源架构应用，以提高使用便利性。	国内先进	旅充、墙充、排插等充电装置
5	四色 (200x200) 电子标签驱动显示驱动芯片	700.00	183.09	278.17	在研	支援四色分辨率 200x200 电子标签显示驱动芯片,预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间，能满足 ESL 多元环境需求。	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
6	四色 (960x680) 电子标签驱动显示驱动芯片	1,200.00	485.28	853.28	在研	支援四色分辨率 960x680 电子标签显示驱动芯片,预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间，能满足 ESL 多元环境需求。	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
7	四色 (800x600) 电子标签驱动显示驱动芯片	900.00	485.28	875.21	在研	支援四色分辨率 800x600 电子标签显示驱动芯片,预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间，能满足 ESL 多元环境需求。	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
8	四色 (400x300) 电子标签驱动显示驱动芯片	700.00	225.95	321.03	在研	支援四色分辨率 400x300 电子标签显示驱动芯片,预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间，能满足 ESL 多元环境需求	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
9	多色	700.00	225.95	225.95	在研	支援多色分辨率	国内先进	电子标

	(200x200) 电子标签驱动显示驱动芯片					200x200 电子标签显示驱动芯片,预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间,能满足ESL多元环境需求。	国内先进	显示屏驱动芯片
10	多色(176x296) 电子标签驱动显示驱动芯片	1,600.00	1,329.96	1,329.96	在研	支援多色分辨率176x296 电子标签显示驱动芯片,预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间,能满足ESL多元环境需求。	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
11	多色(128x250) 电子标签驱动显示驱动芯片	2,400.00	818.65	818.65	在研	支援多色分辨率128x250 电子标签显示驱动芯片,预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间,能满足ESL多元环境需求。	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
12	多色(216x384) 电子标签驱动显示驱动芯片	1,700.00	1,101.63	1,101.63	在研	支援多色分辨率216x384 电子标签显示驱动芯片,预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间,能满足ESL多元环境需求。	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
13	多色(400x300) 电子标签驱动显示驱动芯片	1,800.00	861.09	861.09	在研	支援多色分辨率400x300 电子标签显示驱动芯片,预计更加提升画面刷新速度表现、最适性的温度范围区间,能满足ESL多元环境需求。	国内先进	电子标签显示屏驱动芯片
14	全彩色整合型驱动芯片	1,300.00	188.31	188.31	在研	全彩色整合型电子纸驱动芯片,用于标牌、数码相框中大尺寸等多元化应用,适配全彩色及高分辨率应用。	国内先进	电子纸显示屏驱动芯片
15	全彩色整合型GOA驱动芯片	2,800.00	525.97	525.97	在研	全彩色整合型电子纸驱动芯片(包含GOA功能),用于标牌、数码相框等中大尺寸多元化应用,适配全彩色及高分辨率应用。	国内先进	电子纸显示屏驱动芯片
16	图像处理芯片 Bridge IC	4,500.00	1,506.26	3,122.64	在研	此系列产品能通过高端核心技术替代FPGA,以最佳化的设	国内先	手机、消费电子移动装

						计架构和工艺节点，通过高端核心技术，实现超低功耗，能够大规模地支撑显示需求。	进	置
17	扩充多接口显示驱动芯片	1,900.00	522.03	1,463.21	在研	支持 TFT 480x1334。产品支持 QSPI/RGB/MIPI 多种接口适应多种应用场景。	国内先进	智能家居、智能工控等新应用装置
18	工控横屏 TDDI 显示驱动 IC	2,200.00	1,748.46	1,748.46	在研	支持 1024RGBX1024 分辨率。自带 one-bit Ram 省功耗功能。	国内先进	家电、工控类产品。
19	HD(720x1680) 触控显示增强版整合型驱动芯片	3,500.00	879.96	879.96	在研	研发 A-Si 玻璃高刷新率(15Hz~120Hz)以及高报点率(240Hz)，通过电路优化 AFE 架构以及算法处理，提升触控效能。并透过动态帧率功能以及 4 power 模式达到功耗节能。另下沉式 pad 设计，为终端客户提供 HD 占屏率的解决方案。	国内先进	智慧手机等消费电子
20	AMOLED 智能手机装置显示屏驱动芯片	9,500.00	3,476.59	4,080.41	在研	透过动态高低帧率切换亮度补偿功能，改善显示屏在高低帧率切换时容易发生的亮度抖动问题，采用不同帧率切换时动态调整屏幕驱动电压与亮度开启时间的方式，即可配合不同屏幕的特性，将高低帧率切换亮度抖动的问题改善。本技术为实时性补偿功能，透过动态电压与亮度开启时间的调变，使人眼在任何亮度环境下切换高低帧率都不会因为屏幕亮度变化对人眼造成不适。	国内先进	智能手机等消费电子
21	超静音 APOIS 音圈马达驱动芯片	2,000.00	426.97	1,231.11	在研	兼容不同类型 VCM，超低静音。	国内先进	手机、平板、安防、相机
22	长焦 OIS	1,000.00	700.43	700.43	在研	新一代规格，满足当	国	手机、平

	马达驱动芯片					前终端客户长焦 OIS 马达驱动需求。	内 先 进	板、安 防、相机
合计	/	45,300.00	17,738.73	23,768.11	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度已按之前审议计划进行，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

天德钰无实际控制人。截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东恒丰有限公司的持股数量为 223,216,115 股，报告期内不存在减持，亦不存在质押、冻结的情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的直接持股变动情况如下：

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
郭英麟	董事长兼总经理	442,500	475,996	33,496	实施股权激励
梅琮阳	董事兼副总经理	306,003	337,957	31,954	实施股权激励
谢瑞章	副总经理、董事（离任）	307,500	338,440	30,940	实施股权激励
施青	董事（离任）	-	-	-	/
蔡坤宪	董事	-	-	-	/
黄群辉	董事	-	-	-	/
Kwang Ting Cheng	独立董事	-	-	-	/
韩建春	独立董事	-	-	-	/
陈辉	独立董事	-	-	-	/
陈柏苍	监事会主席（离任）	-	-	-	/
郭初方	监事（离任）	-	-	-	/
张依	职工代表监事（离任）	-	-	-	/
邓玲玲	董事会秘书兼财务总监	77,500	93,650	16,150	实施股权激励
王飞英	市场总监	-	-	-	/
合计	/	1,133,503	1,246,043	112,540	/

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

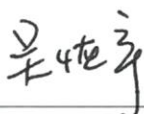
十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:



吴恢宇



禹明旺



中信证券股份有限公司
2026 年 4 月 23 日